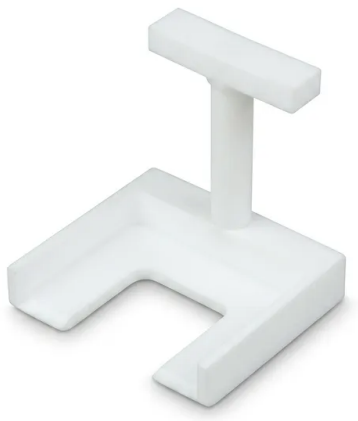
سلة تنظيف رقائق أشباه الموصلات المخصصة من مادة Ptfe المقاومة للتآكل وحامل مختبر منخفض الخلفية

رقم العنصر: PL-CP267



مقدمة

احصل على نقاء فائق في تصنيع أشباه الموصلات باستخدام سلال التنظيف المخصصة من مادة PTFE. مصممة لمقاومة كيميائية شديدة وتداخل منخفض الخلفية، تضمن هذه الحوامل المتينة معالجة فعالة للرقائق، وتصريف سريع، وأداء موثوق في بيئات المختبرات الحرجة عالية النقاء.

اعرف المزيد

التطبيق	الوصف	الفائدة الرئيسية
عملية التنظيف RCA	يستخدم خلال تسلسلات SC-1 و SC-2 لإزالة المخلفات العضوية والملوثات المعدنية من رقائق السيليكون.	يمنع إعادة التلوث بسبب سطح المادة فائق النقاء ومنخفض التسرب.
حفر بيرانا	معالجة الرقائق في خليط من حمض الكبريتيك وبيروكسيد الهيدروجين لإزالة مادة الحساس الضوئي.	مقاومة استثنائية للبيئات المؤكسدة العدوانية دون تدهور هيكلي.
غمر حمض الهيدروفلوريك	إزالة طبقات الأكسيد الأصلية من ركائز السيليكون باستخدام محاليل HF المركزة أو المخففة.	منافع تامة ضد هجوم HF، مما يضمن بقاء المعدات على المدى الطويل ونقاء العملية.
الشطف بعد التلميع الكيميائي الميكانيكي (CMP)	تنظيف الرقائق بعد التلميع الكيميائي الميكانيكي لإزالة جسيمات الملاط والمواد الكيميائية.	يمنع التصريف السريع والخصائص غير اللاصقة التصاق جسيمات الملاط بالسلة.
تطوير الطباعة الضوئية	دعم الركائز أثناء تطوير وإزالة طبقات الحساس الضوئي.	يضمن الاستقرار البعدي العالي المحاذاة الدقيقة والمعالجة خلال خطوات الطباعة الضوئية الحرجة.
تحضير تحليل النزرة	تنظيف أدوات المختبر والحاويات المستخدمة في مطياف الكتلة البلازمية المقترنة حثياً (ICP-MS) وتقنيات تحليلية عالية الحساسية أخرى.	تضمن المستويات المنخفضة جداً للخلفية أعلى دقة في الكشف عن شوائب المعادن النزرة.
معالجة رقائق زرنيخ الغاليوم (GaAs)	معالجة رقائق أشباه الموصلات المركبة من خلال دورات الحفر والشطف المتخصصة.	تمنع الهياكل الداعمة اللطيفة كسر مواد أشباه الموصلات المركبة الهشة.
التنظيف بالموجات فوق الصوتية	يعمل كناقل مغمور أثناء دورات التنظيف الصوتي عالي التردد.	ينقل طاقة الموجات فوق الصوتية بكفاءة مع حماية الرقائق من التلامس الميكانيكي مع الخزان.

المميزة	تفاصيل المواصفات لـ PL-CP267
معرف الموديل	PL-CP267
المادة الأساسية	PTFE (تيفلون) عالي النقاء خام (غير معاد تدويره)
عملية التصنيع	مصنع بدقة CNC بنسبة 100% (بدون مخلفات قولبة بالحقن)
المقاومة الكيميائية	مقاومة كاملة لـ HF، H2SO4، HNO3، HCl، KOH، والمذيبات العضوية
نطاق درجة الحرارة	من -200°C إلى +260°C (من -328°F إلى +500°F)
تشطيب السطح	تشطيب ناعم، منخفض المسامية لتقليل احتجاز الجسيمات
خيارات التكوين	قابل للتخصيص بالكامل (حجم الرقاقة، عرض الفتحة، تباعد الفتحات، تصميم المقبض)
توافق الرقاقة	مناسب لرقائق مقاس 2 بوصة، 3 بوصة، 4 بوصة، 6 بوصة، 8 بوصة، و12 بوصة أو أبعاد مخصصة
تصميم التصريف	ملامح فتحات ذات قاع على شكل V أو U متاحة لتحسين جريان السوائل

التطبيق	الوصف	الفائدة الرئيسية
الميزة	تفاصيل المواصفات لـ PL-CP267	
مستويات الخلفية	معالج خصيصًا لمتطلبات شوائب المعادن دون جزء في المليار (ppb)	